

Камеры термошока жидкостного типа ETSP серия TSL

Производитель:

ETSP Co., Ltd

Цена:

Цена по запросу

Описание

Камеры термошока жидкость-жидкость ETSP серии TSL предназначены для испытания узлов (как правило, микросхем) на термический удар, подвергая их резким перепадам температур путем попеременного погружения в холодную и горячую ванны с жидкостью.

Технические характеристики

Диапазон температур в холодной ванне	-65 °С...0 °С
Диапазон температур в горячей ванне	+70 °С...+150 °С
Точность температуры	менее $\pm 0,5$ °С
Предварительный нагрев горячей зоны	+200 °С
Предварительное охлаждение холодной зоны	-70 °С
Скорость нагрева	+200 °С в течении 80 минут
Скорость охлаждения	-70 °С в течении 90 минут
Время восстановления заданной температуры в ванне	в течении 5 минут
Время перемещения образца между ваннами	Менее 10 секунд